

Thermal Conductive Silicone

A comprehensive range of silicone-based and silicone-free thermal management materials for electronic devices.



Thermal Conductive Silicone



Silicone-based materials such as thermal sheets, gels, adhesives, and greases.

Thermal Conductive Non-Silicone



Silicone-free materials for high-reliability components, such as cameras and sensors.

Application

Mobile & PC Devices



Optimal for CPU/GPU heat dissipation in Lenovo devices (ThinkPad, YOGA, Chromebooks), etc.

Automotive & Industrial Equipment



Thermal solutions for in-vehicle devices, communication infrastructure, and office automation (OA) equipment.

Precision Electronic Parts



Optimal for camera modules and parts where contact failure due to silicone mist must be avoided (Non-Silicone).

LED & Lighting Equipment



Suitable for parts requiring high insulation and heat dissipation performance.

Power Electronics



Optimal for heat management of devices using IGBT, SiC, GaN, etc.

Material Specifications

Silicone Specifications	Silicone Solutions	Non-Silicone Solutions
 Thermal Conductivity	Max 14W/m-K (Gel) Sheet: Max 12.4W/m-K Adhesive: Max 3.8W/m-K	Max 5.0W/m-K (Sheet) Gel: Max 4.6W/m-K
 Insulation	Insulating type lineup available (TCS, TCX series)	Ensures insulation (NF series)
 Hardness & Properties	Low hardness (Shore 00 < 30) with excellent flexibility.	Excellent form followability, no silicone bleeding.
 Oil Bleeding	Low oil bleed type available (e.g., TCS1500R series)	ZD3-D20-0 (Complete Non-Silicone)
 Test Standards	ASTM D5470 compliant	ASTM D5470 compliant



Processing Capabilities

Shape/Form

Sheet: 0.5mm–6.2mm, printable type available (TCS series).
Gel: General, dispensable, moisture-curable.
Adhesive: Single-component moisture-curable, heat-curable (pot life/2K) types.



Application

Compatible with automated equipment, easy peeling, achieves low BLT (min 5µm).



Other Features

High Reliability

Non-silicone prevents contamination of optical parts and contact failure due to silicone mist.



Excellent Thermal Management

High thermal conductivity contributes to greater freedom in thermal design.



Environmental Compliance

RoHS and REACH compliant lineup.



Custom Solutions

Custom material design based on request for thickness, hardness, adhesion, printing, shape, etc.

Representative Product Series

Silicone Series (Examples)

- TCS series (thermal sheet)
- TCA series (thermal adhesive)
- TCG series (thermal gel)
- TCX series (low oil bleed type)

Non-Silicone Series (Examples)

- NF series (thermal sheet)
- NFG series (thermal gel)
- NFA series (thermal adhesive)

USD Price

0.3–2.0 USD /pcs
Price varies based on shape, specification, quantity, etc.



High Performance

Reliable heat dissipation for high-performance devices.



Global Support

Consistent quality and supply for global markets.



Partner for Innovation

Advanced materials to support your next innovation.

Contact Us

Company : RISORA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
Contact : Rumi Imran
Mobile : +91 89259 44244
Email : rumi.imran@morimura.in

Rumi Imran
WhatsApp business account



Company : RISORA



放熱シリコン

電子機器の発熱対策に用いられる、
シリコン系およびシリコンフリーの放熱材料群です。



放熱シリコン

熱伝導シート・ゲル、接着剤、グリース等の
シリコンベース材料。



放熱ノンシリコン

シリコンオイルを含まない、カメラ・センサー等の
高信頼性部品向け材料。

用途

モバイル・PC機器



Lenovo、ThinkPad、YOGA、
Chromebook 等の高性能機器や、
CPU・GPUの発熱に最適。

自動車・産業機器



車載機器、通信インフラ、
OA機器の熱対策。

精密電子部品



カメラモジュール等、シリコン
ミストによる影響を考慮された基板
(ノンシリコン)。

LED・照明機器



高い絶縁性と放熱性が
求められる箇所。

パワーエレクトロニクス



IGBT、SiC、GaN等のデバイスの
熱マネジメントに最適。

材料スペック

項目	放熱シリコン	放熱ノンシリコン
熱伝導率	最大14W/m.K (ゲル) シート：最大12.4W/m.K 接着剤：最大3.8W/m.K	最大5.0W/m.K (シート) ゲル：最大4.6W/m.K
絶縁性	絶縁タイプをラインアップ (TCS、TCAシリーズ)	絶縁性を確保 (NFシリーズ)
硬度・特性	低硬度 (Shore00～30)、 柔軟性に優れる	構造強度性に優れ、 シリコン非抽出
オイルブリード	低オイルブリードタイプあり (TCS1500R等)	エロゾル-D-200 (安全ノンシリコン)
試験規格	ASTM D5470準拠	ASTM D5470準拠

加工スペック



形状・形態

- シート：厚み0.5mm～6.2mm、印刷対応
- ゲル：高粘度のある形態
- 塗布・充填：ディスペンサ装置対応、
高精度なタイプ
- 加工範囲：冷/温度域、放熱特化
(60°C/120°C) タイプ。



施工性

- 自動化対応、剥離容易、
低乱工 (最小8μm) を実現。

その他特長



高信頼性

シリコンコンタミ/シリコンミストによる
光学部品の汚染・障害を未然に防止。



優れた熱マネジメント

高い熱伝導率で、放熱設計の自由度向上に
貢献。



環境適合

RoHS、REACH対応品をラインアップ。



カスタム対応

厚み・硬度・色調・印刷・形状など、
ご要望に合わせた材料設計が可能。

代表製品シリーズ

放熱シリコンシリーズ (例)

- TCSシリーズ (高伝導シート)
- TCAシリーズ (高伝導接着剤)
- TCGシリーズ (低硬度ゲル)
- TCXシリーズ (低オイルブリードタイプ)

放熱ノンシリコンシリーズ (例)

- NFシリーズ (高伝導シート)
- NFGシリーズ (高伝導ゲル)
- NFAシリーズ (低伝導接着剤)

USD価格

0.3～2.0USD/pcs 価格は形状・仕様・数量により変動します。

Contact Us

Company : RISORA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
Contact : Rumi Imran
Mobile : +91 89259 44244
Email : rumi.imran@morimura.in

Rumi Imran
WhatsApp business account



Company : RISORA

